

Advanced Packaging von Halbleitern in der Automobilelektronik

29/09/2026 Der entscheidende Faktor für Rechenleistung und Zentralisierung im Fahrzeug

Advanced Semiconductor Packaging ist längst mehr als nur ein nachgelagerter Schritt in der Halbleiterfertigung. Mit den steigenden Anforderungen moderner Fahrerassistenzsysteme und autonomer Fahrfunktionen werden Bandbreite, Wärmemanagement und Systemintegration zu entscheidenden Leistungsfaktoren. Damit entwickelt sich Advanced Packaging zu einer Schlüsseltechnologie für hohe Rechenleistung, Energieeffizienz und softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen.

Das Strategy Paper von Porsche Consulting zeigt, warum die Zukunft der Fahrzeugelektronik nicht allein vom Chipdesign bestimmt wird. Es beleuchtet die technologischen, wirtschaftlichen und strategischen Auswirkungen moderner Packaging-Technologien für OEMs, Tier-1-Zulieferer und Halbleiterunternehmen. Im Fokus stehen die steigenden Anforderungen an die Rechenleistung, neue

Chiplet-Architekturen sowie die Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen müssen, um Leistungsfähigkeit, Resilienz und Wertschöpfung in der nächsten Generation der Fahrzeugelektronik nachhaltig zu sichern.

Das Strategy Paper in voller Länge lesen: Advanced Semiconductor Packaging in Automotive Electronics

MEDIA ENQUIRIES



Jan Boris Wintzenburg

Director Communications and Marketing
Porsche Consulting GmbH
+49 (0) 152 3911 8663
jan_boris.wintzenburg@porsche-consulting.com

Linksammlung

Link zu diesem Artikel
https://newsroom.porsche.com/de/2026/unternehmen/porsche-consulting-advanced-packaging-von-halbleitern-in-automobilelektronik-43382.html

Media Package
https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/3dcdeb62-b7b4-4f86-b1fa-e331c78ba479.zip

Externe Links
https://www.porsche-consulting.com/de/home/